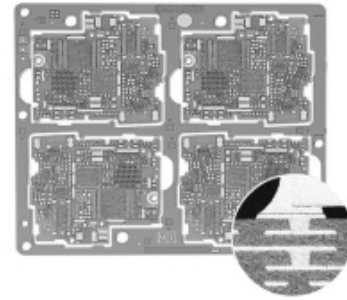


Series: **ALIVH[®]**

Japan
Taiwan

Type: **ALIVH[®]**

絶縁材料にアラミド不織布を採用し、レーザにより形成された微小ビアホールに銅ペーストを充填し、任意の層間を電氣的に接続した全層IVH構造の樹脂多層プリント配線板
工業所有権；特許出願 130件，登録 50件



Type: **ALIVH[®] Gタイプ**

絶縁材料にガラス織布エポキシ樹脂を採用し、ALIVH構造を実現。同時にハロゲンフリー化も実現した全層IVH構造の樹脂多層プリント配線板

■ 特長

- 小形軽量・高密度配線
- 容易な配線設計で設計期間短縮
- RoHS対応

■ 主な用途

- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- 携帯型情報端末機器
- PCカード

■ 基本性能

項目	ALIVH [®]	ALIVH [®] Gタイプ	
基板材料	アラミド不織布 エポキシ樹脂	ガラス織布エポキシ樹脂	
基板厚み (標準) mm	8層 0.75 ~ 0.95	0.60 ~ 1.00	
ビア径	μm	最小150	
ピアランド径	μm	最小300	
線幅/線間	μm	最小60/70	
誘電率(1 GHz)	—	3.7	4.6
密度	g/mL	1.4	2.0

■ 取得規格

UL規格 (File No. E36779)

● Type : ALIVH[®]

生産地	UL品番	難燃性	基 材	導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)		
日本	EBKN2	94V-0	—	0.025	0.05	19.8	270, 20	120
	EBKN1	94V-0	—	0.025	0.05	19.8	260, 20	120

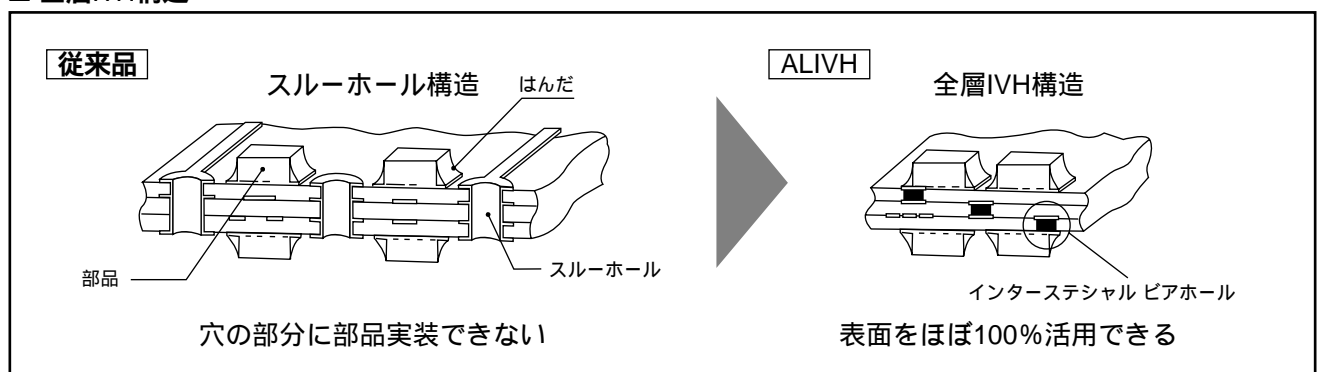
上表の数値はUL取得内容であり，設計を示す数値ではありません。

● Type : ALIVH[®] Gタイプ

生産地	UL品番	難燃性	基 材	導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)		
日本, 台湾	EBKN7	94V-0	FR-4	0.025	0.05	19.8	270, 20	105

上表の数値はUL取得内容であり，設計を示す数値ではありません。

■ 全層IVH構造



“ALIVH[®]” は日本国登録商標です。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。